

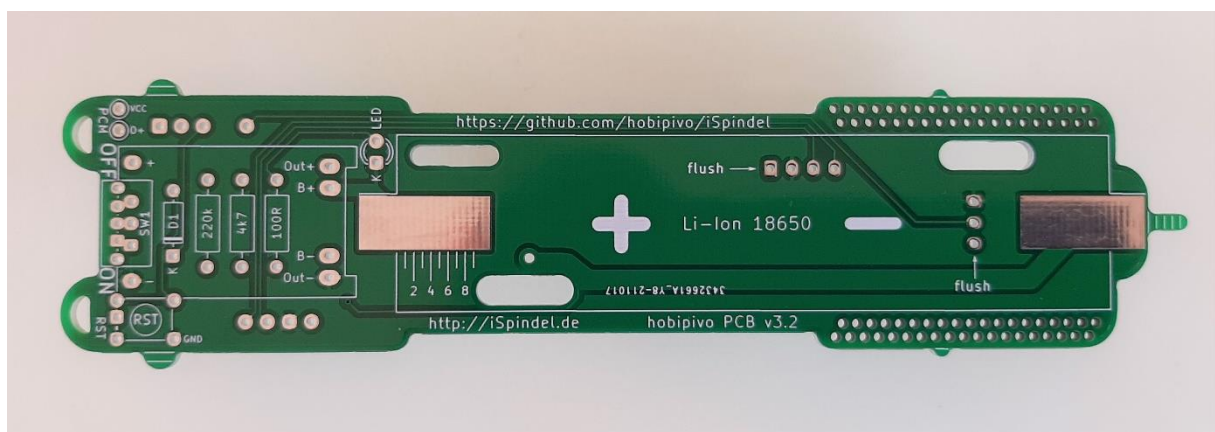
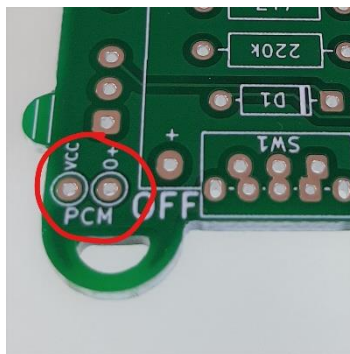
# iSpindel hobipivo PCB-Versionen

## Version 3.2 (Dezember 2021)

Kontakte für Stromverbrauchsmessung „PCM“

Verkleinerung von Ausziehlöchern (mehr Platz für Beschriftung)

Anpassungen Beschriftung etc.

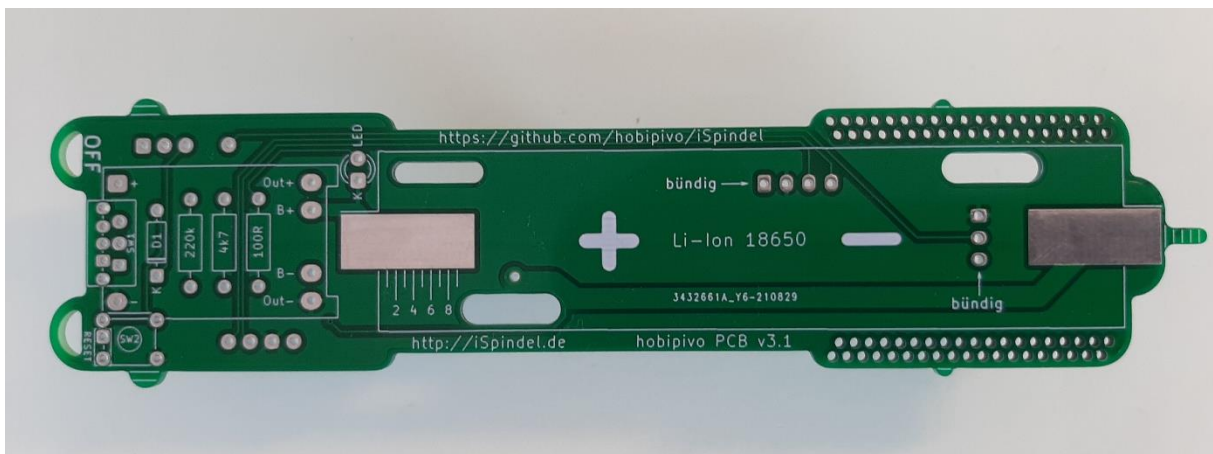
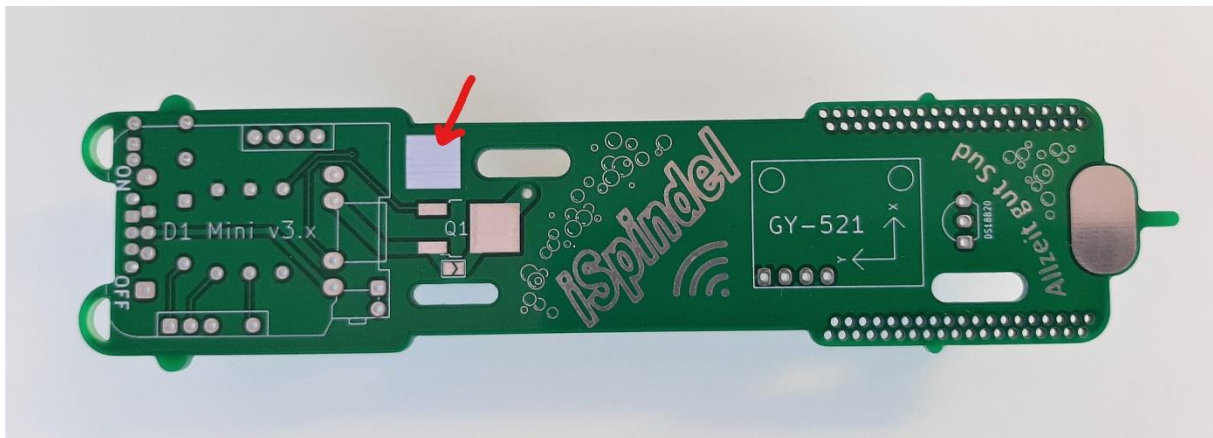
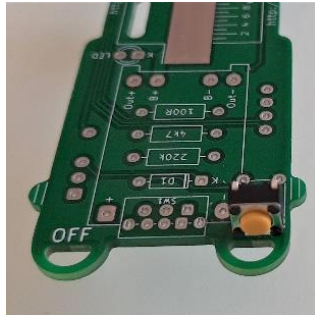


### Version 3.1 (November 2021)

Wiedereinführung von Beschriftungsfeld

Verschiebung RESET-Taster > Deckel für senkrechte oder waagrechte Montage

Feinanpassungen

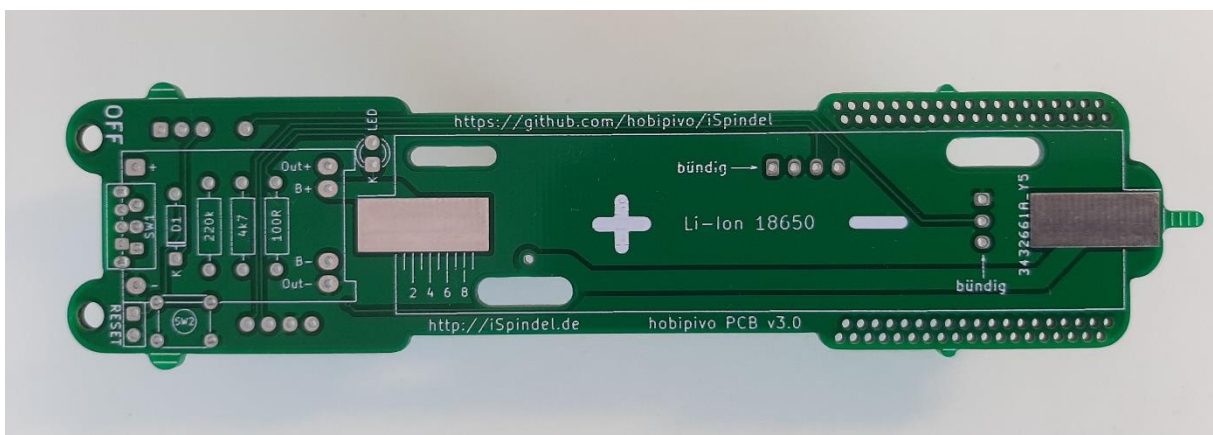
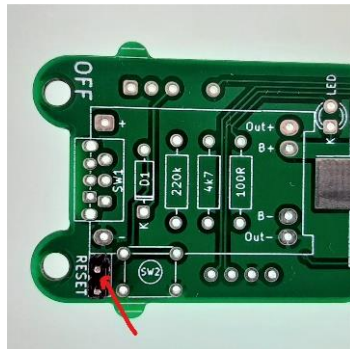


### Version 3.0 (Oktober 2021)

Mit optionalem RESET – Jumper und Taster OMR **B3F-1002**

Optimiert für Eigenmontage (kleinere THT-Durchkontaktierungen)

Ausbalanciert + Feinanpassungen



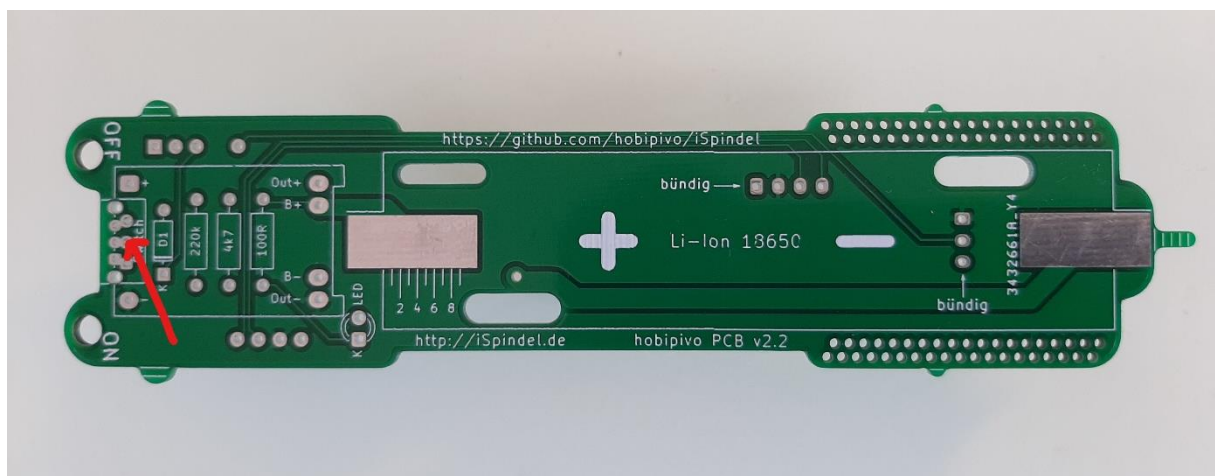
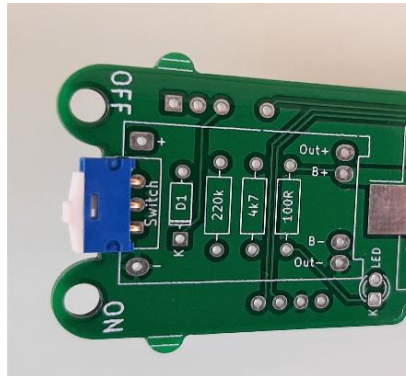


## Version 2.2 (August 2021)

Alternativer Schiebeschalter EGE SS **ESP201** RM 2,54

Erweiterung Graphik mit CO<sup>2</sup> Blasen

Feinanpassungen



Montagemöglichkeit für alternativen Schiebeschalter

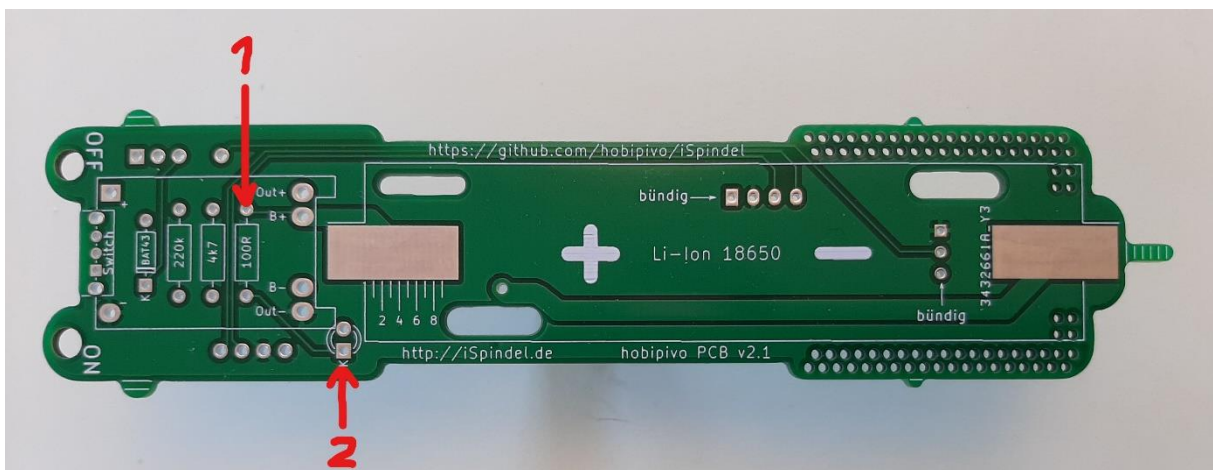
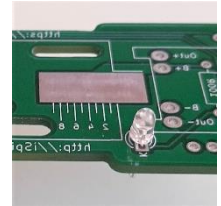
## Version 2.1 (Juli 2021)

Mit optionaler optischen Verpolungswarnung -anzeige:

- Verwendung von LED (D2) THT 3mm wasserklar hyper-red
- Verwendung von Widerstand (R3) 100 bis 150 Ohm 0,6W

Verkleinerung Lötpad

Feinanpassungen



- 1 > Vorwiderstand (R3) THT axial 100 – 150 Ohm
- 2 > LED (D2) THT radial 3mm wasserklar Hyper-Red

## Version 2.0 (Mai 2021)

Mit optionalem elektronischen Verpolungsschutz:

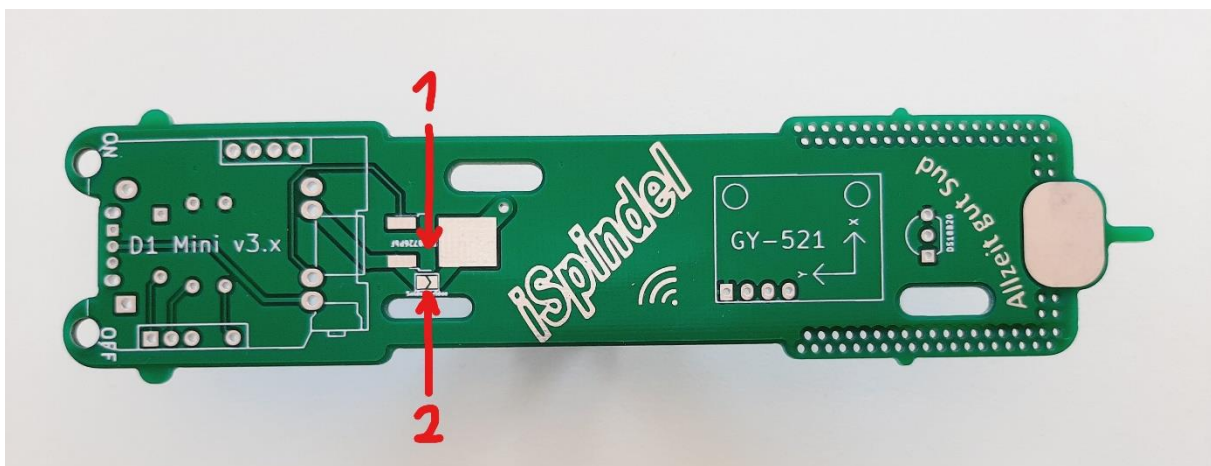
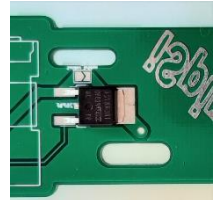
- Verwendung von N-CH MOSFET IRLR8726PBF im TO-252AA Gehäuse
- Platzierung von Lötbrücke zur möglichen Überbrückung, wenn der Verpolungsschutz nicht verwendet werden sollte

Entfernung der zusätzlichen Reset-Funktion

Abstandserweiterung der DS18B20 Lötpins

Zusätzliche Abstandshalter

Zusätzliche Beschriftung und Feinanpassungen



- 1 > SMD Löt pads für N-CH MOSFET Transistor im SOT-252AA oder SOT-223 Gehäuse
- 2 > Lötbrücke (falls der Verpolungsschutz-Transistor nicht verwendet wird)



## Version 1.0 (Jänner 2021)

Die v1.0 Platine dient als Prototyp für v2.0

In Anlehnung ans Jeffrey Board wurde dieses um folgende Punkte geändert/erweitert:

- Erweiterung/Änderung der Platinen-Führungsnasen im PETling
- Aufdruck von gut sichtbaren + - Zeichen für den Akkueinbau
- Änderung der Widerstandspositionen (keine zusätzlichen Durchkontaktierungen)
- Verschiebung des D1 mini Modules näher Richtung Deckel  
(Lötstellen von Lademodul beim Wemos nicht mehr im Weg)
- Verschiebung und Änderung des Lademoduls Footprints (Pin-Abstände)
- Änderung des Styles und Position des GY-521 Footprints
- Aufgeräumte Beschriftung
- Verwendung von Kupferplanes für VCC und GND
- Lötpad für Austarieren (24-26° im Wasser)

